

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011 年 12 月 22 日(22.12.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/158550 A1

- (51) 国際特許分類:
B65D 73/02 (2006.01) *B65D 65/02* (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01) *B65D 85/38* (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/059545
- (22) 国際出願日: 2011 年 4 月 18 日(18.04.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-135800 2010 年 6 月 15 日(15.06.2010) JP
特願 2010-135799 2010 年 6 月 15 日(15.06.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 電気化学工業株式会社(DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 佐々木 彰 (SASAKI Akira) [JP/JP]; 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP). 徳永 久次 (TOKUNAGA Hisatsugu) [JP/JP]; 〒3720855 群馬県

伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP). 藤村 徹夫(FUJIMURA Tetsuo) [JP/JP]; 〒3720855 群馬県伊勢崎市長沼町西河原 2 4 5 番地 電気化学工業株式会社 伊勢崎工場内 Gunma (JP).

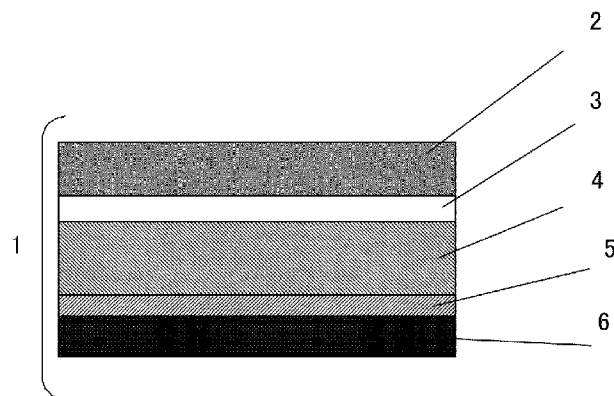
- (74) 代理人: 園田 吉隆, 外 (SONODA Yoshitaka et al.); 〒1630434 東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号 新宿三井ビル 3 4 階 園田・小林特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア

[続葉有]

(54) Title: COVER TAPE

(54) 発明の名称: カバーテープ

[図1]



(57) Abstract: Disclosed is a cover tape which comprises at least a base layer (A), an intermediate layer (B), a peeling layer (C), the primary component of which is a thermoplastic resin, and a heat seal layer (D), the primary component of which is a thermoplastic resin that can be heat sealed to a carrier tape. The tensile storage modulus (c) of the thermoplastic resin that constitutes the peeling layer (C) is within the range of 1×10^6 Pa to 1×10^8 Pa. The tensile storage modulus (d) of the thermoplastic resin that constitutes the heat seal layer (D) is within the range of 1×10^8 Pa to 1×10^{10} Pa. The ratio of (c) and (d) satisfies $1 \times 10^4 \geq (d)/(c) \geq 1 \times 10$. This kind of cover tape has the appropriate peel strength and sufficiently low fluctuation in peel strength when heat sealed to a thermoplastic resin carrier tape. Therefore, the tape will not tear even under shock caused by high-speed peeling, and adherence of electronic parts does not occur even when set aside for a long period of time of 24 to 72 hours in a high-temperature environment of 60 to 80°C.

(57) 要約:

[続葉有]



WO 2011/158550 A1



(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR,
NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

基材層 (A)、中間層 (B)、熱可塑性樹脂を主成分とする剥離層 (C)、及びキャリアテープにヒートシール可能な熱可塑性樹脂を主成分とするヒートシール層 (D) を少なくとも含んでなり、剥離層 (C) を形成する熱可塑性樹脂の引張貯蔵弾性率 (c) が $1 \times 10^6 \text{ Pa}$ 以上で $1 \times 10^8 \text{ Pa}$ 以下であり、ヒートシール層 (D) を形成する熱可塑性樹脂の引張貯蔵弾性率 (d) が 1×10^8 以上で $1 \times 10^{10} \text{ Pa}$ 以下であり、かつ、(c) と (d) の比が、 $1 \times 10^4 \geq (d) / (c) \geq 1 \times 10$ である、カバーテープが開示される。このようなカバーテープは、熱可塑性樹脂製キャリアテープにヒートシールしたときに、適度の剥離強度を有し且つ剥離強度のバラツキが十分小さいために、高速剥離による衝撃によってもテープ切れが起こらない上に、 $60 \sim 80^\circ\text{C}$ のような高温環境下で $24 \sim 72$ 時間のような長時間置かれても、電子部品の付着が起こらない。